



가

10

가

가 가 가 가 가 가 가 가 가 UV 가 가 가 가 가 150_°C 500,000dyne/cm² 150_°C 가 가 가 가 가 가 가 가



Ceramic Cutting Tape



DICING Tape

가

가

| フト フト フト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 가 () 가 가 가 가 |
|--|---|
| , . 가 | , 가 가 가 . 가 . |
| . 가 가 , , , ChipInductor MLCC | () 가 가 가 가 가 가 |
| · 가 () 가 , 가 | ・ 가 ' ' () 가 가 가 가 가 가 가 가 가 |

Normal Wafer Back Grinding Tape



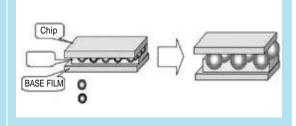


가 ()

가 ()

가 가 80% 4,000,000 가 () 가

> () 가



가 가 가 가

() 가

가

• 2005.5